



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201854500 U

(45) 授权公告日 2011.06.01

(21) 申请号 201020589460. X

(22) 申请日 2010.11.03

(73) 专利权人 竞陆电子(昆山)有限公司

地址 215300 江苏省苏州市昆山市经济技术
开发区金沙江北路 1818 号

(72) 发明人 李泽清

(74) 专利代理机构 昆山四方专利事务所 32212

代理人 盛建德

(51) Int. Cl.

H05K 1/02(2006.01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

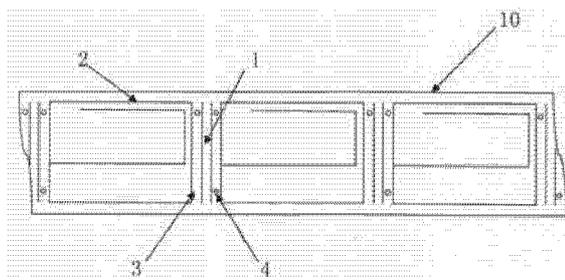
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

电路板的拼板阻抗条改良结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电路板的拼板阻抗条改良结构,所述阻抗条位于拼板上待切割分离的相邻的电路板之间,所述阻抗条与电路板相邻的两侧向外延伸出定位边,在制作过程中即增加了阻抗条的外围尺寸,所述两侧定位边内共至少开设有三个定位孔,定位孔的数量根据阻抗条的长度来决定,在切下阻抗条使电路板成型时,因定位孔的定位作用铣刀受力的作用不会使阻抗条偏移,有效降低了镑歪报废,即降低了电路板成型时的报废率。



1. 一种电路板的拼板阻抗条改良结构,所述阻抗条(1)位于拼板(10)上待切割分离的相邻的电路板(2)之间,其特征在于:所述阻抗条(1)与电路板(2)相邻的两侧向外延伸出定位边(3),所述两侧定位边(3)内共至少开设有三个定位孔(4)。

2. 根据权利要求1所述的电路板的拼板阻抗条改良结构,其特征在于:所述两侧定位边(3)内共开设定位孔(4)的总数为奇数,其中一侧定位边(3)内开设的定位孔(4)的数量比另一侧定位边(3)内开设的定位孔(4)的数量少一个。

3. 根据权利要求1所述的电路板的拼板阻抗条改良结构,其特征在于:所述两侧定位边(3)内共开设定位孔(4)的总数为偶数,该两侧定位边(3)内开设的定位孔(4)的数量一致。

4. 根据权利要求3所述的电路板的拼板阻抗条改良结构,其特征在于:所述两侧定位边(3)内开设的定位孔(4)一一对应。

电路板的拼板阻抗条改良结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电路板拼板上的阻抗条结构,尤其是一种电路板的拼板阻抗条改良结构。

背景技术

[0002] 在一些电路板(PCB)设计的时候,对于走线的宽度是有严格规定的,如:RF PCB,对于RF信号的走线的宽度有严格的规定,设计的时候要根据PCB的厚度和介电常数需要严格计算、仿真走线在对应的频点上的阻抗,以确保其为50欧(CATV的标准为75欧);然而,并不是时时刻刻我们都需要严格的阻抗匹配,在某些情况下,较小的阻抗失配可能无关大碍(比如40欧~60欧);而且,即便你对板子的仿真是基于理想情况下做的,实际交给PCB厂生产的时候,厂商所使用的工艺会导致板子的实际阻抗和仿真结果相差千里;因此对于PCB生产厂而言,面对此类PCB在设计时会在客户所设计的PCB外延以拼板的形式制作一个阻抗条,在出厂的时候测试一个阻抗条上的一个对应宽度的样本走线的阻抗来大致确定板子上同样宽度走线的阻抗。最后这个阻抗条被最终切下并回收,但由于目前所有阻抗条均未设定位孔,遇到多根阻抗条连排料号的情形,在切下阻抗条使PCB成型时因铣刀受力的作用经常有无法定位的阻抗条偏移,造成镑歪报废。

发明内容

[0003] 为了克服上述缺陷,本实用新型提供了一种电路板的拼板阻抗条改良结构,可有效减少电路板成型时的报废率。

[0004] 本实用新型为了解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种电路板的拼板阻抗条改良结构,所述阻抗条位于拼板上待切割分离的相邻的电路板之间,所述阻抗条与电路板相邻的两侧向外延伸出定位边,在制作过程中即增加了阻抗条的外围尺寸,所述两侧定位边内共至少开设有三个定位孔,定位孔的数量根据阻抗条的长度来决定,在切下阻抗条使电路板成型时,因定位孔的定位作用铣刀受力的作用不会使阻抗条偏移,有效降低了镑歪报废,即降低了电路板成型时的报废率。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进,所述两侧定位边内共开设定位孔的总数为奇数,其中一侧定位边内开设的定位孔的数量比另一侧定位边内开设的定位孔的数量少一个。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进,所述两侧定位边内共开设定位孔的总数为偶数,该两侧定位边内开设的定位孔的数量一致。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进,所述两侧定位边内开设的定位孔一一对应。

[0009] 本实用新型的有益效果是:阻抗条与电路板相邻的两侧向外延伸出定位边,于定位边内开设定位孔,在切下阻抗条使电路板成型时,因定位孔的定位作用铣刀受力的作用不会使阻抗条偏移,有效降低了镑歪报废,即降低了电路板成型时的报废率。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所对比的原有技术的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 实施例：一种电路板的拼板阻抗条改良结构，所述阻抗条 1 位于拼板 10 上待切割分离的相邻的电路板 2 之间，所述阻抗条 1 与电路板 2 相邻的两侧向外延伸出定位边 3，在制作过程中即增加了阻抗条的外围尺寸，所述两侧定位边 3 内共至少开设有三个定位孔 4，定位孔的数量根据阻抗条的长度来决定，在切下阻抗条使电路板成型时，因定位孔的定位作用铣刀受力的作用不会使阻抗条偏移，有效降低了镑歪报废，即降低了电路板成型时的报废率。

[0013] 所述两侧定位边 3 内共开设定位孔 4 的总数为奇数，其中一侧定位边 3 内开设的定位孔 4 的数量比另一侧定位边 3 内开设的定位孔 4 的数量少一个。

[0014] 所述两侧定位边 3 内共开设定位孔 4 的总数为偶数，该两侧定位边 3 内开设的定位孔 4 的数量一致。

[0015] 所述两侧定位边 3 内开设的定位孔 4 一一对应。

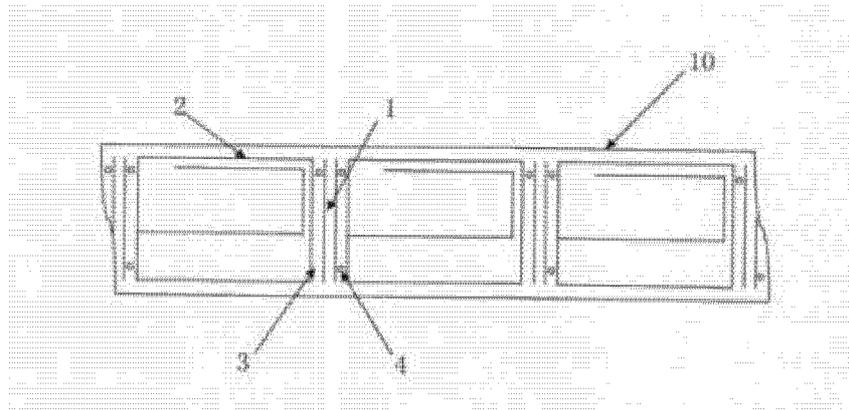


图 1

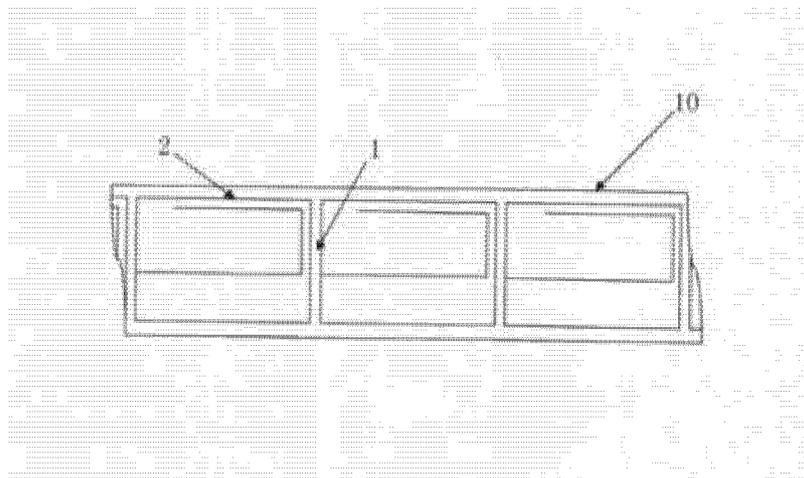


图 2